

製品・技術 PR レポート

1. 企業概要

会社名	株式会社サンテック			代表者名	日野 榮		
				窓口担当	西脇 行広		
事業内容	半導体・他 ダイシング加工			URL	http://www.c-suntec.co.jp		
主要製品	BG加工・ダイシング加工・トレー詰・外観検査までの作業を受託						
住所	東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10						
電話番号	042-557-7744			FAX 番号	042-557-7745		
資本金(M¥)	10	設立年月日	平成9年3月	売上(M¥)	384	従業員数	41

2. PR事項

『加工の難しいあらゆる素材に対応するダイシング加工技術を提供します』

半導体用シリコンウエハのダイシングメーカーとして、「より早く・安定した精度で・より低コストで」を合言葉に微細加工技術を追求しております。この加工技術を当社では加工の難しいあらゆる素材にも展開しお客様より評価を戴いております。この素材は切れないと諦めていませんか？是非一度御相談下さい！

【加工技術】

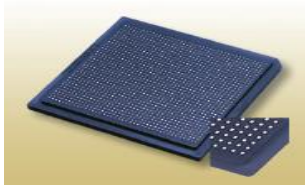
	ワークサイズ	加工寸法	精度
BG加工	8インチまで	30 μ (t)	$\pm 3\mu$ 以内
ダイシング加工	12インチまで	0.3 mm \square	0.3 mm \square
チップソート	12インチまで	0.3 mm \square	24 分類可能
外観検査	金属・実体顕微鏡にて $\times 25$ 以上検査実施		



※上記の内容は半導体用シリコンウエハでの条件です。

【加工事例】

半導体シリコン



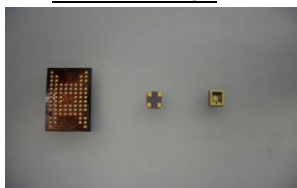
微細チップの加工については0.3mm \square のチップ化・トレー詰(整列)が可能です。
(加工精度: チッピング 10 μ 以内)

光学ガラス



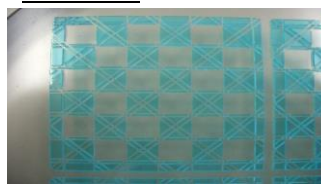
携帯電話・デジタルカメラ等に使用する光学ガラスのチップ化・トレー詰(整列)を行います。
(加工精度: 寸法公差 $\pm 10\mu$ 以内)

ガラエポ基板



多層基板を高精度にダイシング加工します。
(加工精度: 寸法公差 $\pm 10\mu$ 以内)

特殊素材



水晶等切断の難しい素材についてもダイシング加工します。

3. 特記事項

- 平成 14 年 10 月 ISO9001・2000 認証取得
- 平成 16 年 11 月 ISO14001 認証取得